

2024 年 12 月 4 日

三井化学株式会社

三井化学グループ、「SEMICON® JAPAN 2024」に出展

三井化学株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：橋本 修）、三井化学 ICT マテリア株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：才本 芳久）、および三井化学ファイン株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：西山 泰倫）は、2024 年 12 月 11 日から 13 日に東京ビッグサイトで開催される「SEMICON® JAPAN 2024」に三井化学グループとして出展いたします。

ブース内では、世界シェア No.1 のイクロステープ™や三井ペリクル™、半導体実装工程に関わる新製品、フッ素代替案材料、特殊モノマー素材、MI（Materials Informatics）、環境への取り組み、等の半導体のロードマップを見据えた新しい技術やソリューションの提案を致します。

皆様のお越しを心よりお待ちしております。



【展示会概要】

展示会名：「SEMICON® JAPAN 2024」

開催期間：2024 年 12 月 11 日（水）～13 日（金）10：00～17：00

会場：東京ビッグサイト（東京国際展示場）東展示棟 1-8 ホール

三井化学グループブース 1434（東 1 ホール）

（三井化学・三井化学 ICT マテリア・三井化学ファイン 共同ブース）

*ご来場の際は、SEMICON® Japan 公式サイトより事前登録をお願いいたします。

<https://www.semiconjapan.org/jp/about/pricing-and-register>

【三井化学グループ出展内容】

展示テーマ（ソリューション・製品）	担当部署
三井ペリクル™	三井化学（株） ICT ソリューション事業本部 半導体・光学材料事業部
ミレックス®	三井化学（株）
ハイブリッド接合向け低温接合材	ICT ソリューション事業本部
PFAS フリー超高温耐熱剥離型フィルム	ICT 材料事業推進室
イクロステープ™ （高温プロセス用保護テープ、高温・低温ファイナルテストソリューション、 ハイブリッドボンディング向けソリューション、ゼロストレス剥離ソリューション）	三井化学 ICT マテリア（株） プロテクトフィルム事業部
PFAS フリーモールド剥離型フィルム	
高耐熱・低誘電 アミン化合物(FCCL/CCL 用ポリイミド樹脂原料)	三井化学ファイン（株） パーソナルケア材料事業部門 ファインケミカル部
クリエイティブ インテグレーション ラボ®	三井化学（株） 研究開発本部 ICT ソリューション研究センター
マテリアルズ・インフォマティクス	三井化学（株） 生産技術研究所
フッ素樹脂代替提案 TPX® 超高分子量ポリエチレン 微粒子パウダー ミペロン® 超高分子量ポリエチレン 射出成形押出成形可能ペレット リュブマー®	三井化学（株） ICT ソリューション事業本部 半導体・光学材料事業部
半導体製造のサステナビリティへの貢献に向けて	三井化学（株） ICT ソリューション事業本部 企画管理部

以 上

<お問い合わせ先> 三井化学株式会社

ICT ソリューション事業本部 企画管理部 TEL : 03-6880-7474

コーポレートコミュニケーション部 TEL : 03-6880-7500

お問合せフォーム https://form.mitsuichemicals.com/corporate/cc_pr_csr_ja?param=13